

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 30 日（周四）下午 15:00~16:30
地点	全景路演（ https://rs.p5w.net/html/177690871572020.shtml ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 蔡华波 独立董事 唐忠诚 副总经理、董事会秘书 许刚翎 副总经理 黄强 财务负责人 黎玉华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2026 年 4 月 30 日，公司在全景路演平台举行了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。公司高管对报告期内业绩情况进行了分析，并与参会的投资者进行了互动交流，详细情况如下：</p> <p>1、如何看待存储产业未来的供需格局？如何看待存储价格的趋势？</p> <p>答：AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量。云端 AI 相关的 HBM、</p>

RDIMM、eSSD 等产品已经消耗了大量现有产能，后续端侧 AI 存储需求也将进一步释放。晶圆原厂产能目前难以满足存储需求，且产能扩张需要一定扩产周期，因此存储产业未来一段时间仍将呈现供不应求的产业格局。

2、端侧 AI 趋势下公司有哪些发展机会，自研芯片方面有怎样的规划？

答：端侧 AI 对存储产品提出了高性能、大容量、低延迟、低功耗、小尺寸以及定制化的更高综合要求。公司围绕端侧 AI 应用场景推进产品化落地，已形成了覆盖芯片设计、固件算法开发、封装测试、材料工程等环节的集成存储能力。基于主控芯片能力，公司已经推出了 HLC 技术，该技术能够明显降低 DRAM 的使用量，从而缩减终端设备的综合存储成本。HLC 技术已完成了与 AMD、紫光展锐的联合调优，公司正推进相关技术的产品化和市场推广。

3、HLC 技术及相应的软硬件生态有多大的市场空间？HLC 技术的客户导入进度如何，后续起量节奏是怎样的？

答：从行业趋势来看，未来一段时间将是端侧 AI 应用的爆发期，相关存储产品的应用场景覆盖 AI 手机、AI PC、AI 穿戴、智能驾驶等领域，市场空间广阔。HLC 技术依托公司自研的高性能主控与自研固件，使 NAND 存储设备能够承接原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，在保证客户体验不变的前提下，实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解。HLC 技术目前已经和 AMD、紫光展锐等生态伙伴合作完成技术验证，公司正推进相关技术的产品化和市场推广。

4、晶圆原厂更多聚焦 AI 相关需求的背景下，公司在哪些领域实现份额的提升？

答：晶圆原厂资源正向云端 AI 存储市场倾斜，而端侧 AI 应用场景分散，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 穿戴、智能驾

驶、人形机器人等多个领域，需要本地化部署和差异化产品服务，这正是公司的擅长领域，公司也较为看好相关领域的发展机会。

5、公司会采取哪些措施应对存储行业的价格周期波动？

答：公司将以提升经营质量为核心，聚焦价值产品和价值客户突破，通过“往高端走、往海外走、往品牌走、往端侧 AI 走”的战略提升抗周期能力。公司将着力突破高端市场与品牌市场，提升业务抵抗价格波动相关风险的能力。公司将重点布局端侧 AI 相关市场，机器人、自动驾驶等端侧 AI 领域对成本上涨的容忍度更高，更看重产品交付和产品实现能力，相关业务的拓展能够提升经营稳健性。公司也将持续投入技术研发，通过 HLC 等技术帮助客户提升 DRAM 使用效率，共同解决成本和交付问题，实现公司和客户的共同成长。

6、公司在存储器产业链各环节上的优势和劣势分别是什么？公司未来是否还将继续聚焦于主控芯片开发？公司会在哪些环节上继续补强整体竞争力？

答：公司主控芯片研发聚焦于提供差异化价值，而非开发标准化的产品，标准化主控上，公司仍会和现有合作伙伴深入合作。针对端侧 AI 场景，公司已推出了多款主控芯片，以满足不同端侧应用场景的个性化需求。例如，公司针对车载场景专门设计了车载 USB 主控芯片，解决了普通 U 盘应用在汽车上的 EMI（电磁干扰）问题，目前公司车规级产品已经大规模供应北美智能汽车及自动驾驶科技巨头等全球头部客户的供应链体系中，并取得了一定的市场份额。面向端侧 AI 对存储提出的高度定制化需求，公司旗下苏州元成并非定位于普通 OSAT 代工，而是致力于提升整体工程与制造能力，以更好地支撑定制化产品的深度开发，提高产品附

加值，并与原厂形成互补。

7、公司企业级存储业务当前进展如何？今年的放量节奏和业绩贡献预期是怎样的？

答：公司在企业级业务上坚持差异化、价值化、定制化路线，与原厂形成错位竞争，2025年上半年中国企业级 SATA SSD 总容量排名中，公司在国产品牌中位列第一。公司的 SPU 芯片也可应用在数据中心市场，能够支持单盘 128TB 的超大容量，可实现盘内无损数据压缩，并通过 HLC 技术帮助客户降低整体存储成本。

8、公司 TCM 模式业务目前的进展如何？未来在整体收入中的占比有怎样的规划？

答：TCM 模式可以实现原厂、江波龙和客户三方的信息互通，目前公司 TCM 模式的技术和运营准备已经完成，部分案例已经落地，但在整体营收中的占比仍然较低。TCM 模式是公司长期的战略方向，模式落地后会对公司利润贡献有明显提升，公司将在遵循企业会计准则的前提下，持续扩大 TCM 模式业务在营收中的占比。

9、公司未来主控芯片业务的内部规划和业务定位是怎样的？

答：公司的主控芯片研发基于用户场景设计，而非单纯开发标准化主控。公司的主控芯片布局将从嵌入式领域延伸，覆盖 SSD、USB、SD 卡等多个产品线，同时兼顾 JEDEC 标准需求和端侧 AI 应用场景的差异化需求。

10、公司在资源供应保障上有怎样的布局？

答：公司与国内外多家原厂有十年以上的长期合作关系，并基于集成存储能力，能够为原厂及客户提供差异化价值。公司已经与多家原厂持续签订 LTA 或 MOU，保障供应链稳定。

11、公司在新型内存模组方面有怎样的规划？相关产品

的商业化落地进度如何？

答：公司已经发布 SOCAMM2 产品，适用于数据中心、服务器等云端 AI 场景。公司也将持续开发具备高带宽、低功耗、成本及灵活性优势等创新型 AI DIMM 产品，以满足 AI 落地下各类应用领域的需求。

12、公司的 HLC 技术具体实现原理是怎样的？该技术是否依赖先进制程主控芯片的能力？

答：HLC 技术高度依赖公司自研主控芯片与自研固件能力，同时 NAND Flash 的接口传输速率的高速增长，也为 HLC 技术实现提供了必不可少的底层硬件基础。HLC 技术通过与主芯片的配合，根据系统数据的热、温、冷活跃度以及对交换速度的要求，在不同存储系统中对数据进行有效调度和管理，在保障系统性能的前提下，使 NAND 存储设备承接原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，降低部分 DRAM 容量需求。由于单位容量 DRAM 成本高于 NAND Flash，该技术可以为端侧 AI 应用提供更具成本优势的存储解决方案。

13、Lexar（雷克沙）品牌今年是否会继续保持高增长？

答：Lexar（雷克沙）自 2017 年公司收购后，过去几年保持明显增长，目前其收入超过半数来源于全球市场，公司也通过赞助世界杯等国际赛事匹配其全球化的业务形态。目前搭载 SPU、存储智能体以及软硬件结合的 AI storage core 系列新产品已经推向市场，结合产品、技术和市场策略三个维度的布局，公司对 Lexar（雷克沙）今年保持良好的发展势头有充足信心，具体业绩数据公司会依法依规进行披露。

14、公司全资控股 Zilia 后，对巴西及拉美市场的拓展是否会进一步提速？

答：公司 2023 年收购 Zilia 81% 的股权，经过数年的业务协同，Zilia 在巴西实现了快速增长，因此公司提前回购剩

余 19%股权实现全资控股。公司将发挥中国的工程师和供应链优势，服务巴西本土客户以及在巴西的中国企业；公司将依托巴西的特殊关税政策，以巴西为基地辐射欧洲和整个美洲区域，支撑公司出海业务实现稳健成长。

15、二季度江波龙还有多少库存？

答：尊敬的投资者，您好。截至 2026 年一季度末，公司存货规模为 179.61 亿元。公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，通过签署长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），为公司未来发展构建起了有韧性及有保障的晶圆供应体系。具体二季度相关数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

16、公司有没有研发 HBM 布局 AI 产业？

答：尊敬的投资者，您好。目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂为主导，公司并未从事 HBM 的专项研发。在 AI 大模型应用快速发展的背景下，公司推出了 SATA SSD、PCIe SSD、RDIMM 等企业级存储产品，并发布了 MRDIMM、CXL2.0 内存拓展模块、SOCAMM2 等多款前沿高性能存储产品，客户涵盖运营商、互联网企业、服务器厂商等。面向 AI 端侧设备，公司推出了 UFS4.1、mSSD、超薄 ePOP4x 等高端存储产品，并持续推进相关产品在智能终端客户的导入与量产。感谢您的关注。

17、请教，公司如何锁定原材料价格，公司 1 季度的利润增长有多大比例来自于存货涨价？

答：尊敬的投资者，您好。公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，通过签署长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），为公司未来发展构建起了有韧性及有保障的晶圆供应体系。感谢您的关注。

18、如何切实有效，保护中小投资者的利益？

答：尊敬的投资者，您好。公司严格规范公司治理、强

化信息披露、保持稳定现金分红、规范股东减持、畅通投资者沟通渠道，公平保障所有股东知情权、参与权与收益权。感谢您的关注。

19、各位管理层，大家好！我想请教一个问题：自研主控芯片目前迭代和量产进度如何？37亿定增投向AI高端存储项目，目前建设和进度如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司已成功自研SPU（存储处理单元）、UFS 4.1等多款采用同等先进制程的主控芯片。凭借“主控芯片+固件算法”的底层协同，公司能够推出在性能与能效方面领先市场的新一代高端存储产品，并实现创新性的存储功能，如通过将SPU与iSA（智能存储体）及HLC（高级缓存技术）技术相结合，可高效识别并下沉温冷数据，显著降低终端设备的DRAM容量需求。在端侧AI加速落地的趋势下，自研芯片能力将不断转化为公司的差异化竞争壁垒，巩固并提升公司在高端存储领域的领先地位。具体主控芯片进展请以公司公开发布的信息为准。感谢您的关注。

20、全球存储原厂（三星/美光）都在扩产，2027年供需可能过剩，你们作为无晶圆厂，在周期底部如何生存？

答：尊敬的投资者，您好。随着AI大模型的爆发式增长，存储供需缺口日益凸显，构建极具韧性的供应保障体系，已成为存储企业的核心壁垒之一。公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，通过签署长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），为公司未来发展构建起了有韧性及有保障的晶圆供应体系。凭借全栈式技术能力、全球化品牌影响力与渠道布局等综合优势，公司有效助力晶圆原厂实现从晶圆到终端产品的高效转化与规模化落地，与原厂的合作已超越常规采买关系。随着全球原厂产能与研发重心向服务器市场迁移，公司在消费级存储市场将持续强化应用拓展与客户定制化服务能力，进一步深化与

全球晶圆原厂的“错位协同”合作，共同把握智能终端市场的发展机遇，实现更高层次的战略共赢。感谢您的关注。

21、研发投入率仅 5%（兆易创新 12%-18%），每年花几亿买颗粒、几千万研发，核心技术空心化，如何支撑 1600 亿市值？

答：尊敬的投资者，您好。持续的研发投入是产品创新和保持竞争优势的基石。公司将增加关键领域的研发支出，专注于新一代主控芯片设计及高端存储产品开发，进一步强化在垂直整合半导体供应链中的独特优势，为客户提供更广泛、更高性能的创新存储解决方案。感谢您的关注。

22、有息负债近 95 亿、资产负债率 59%，行业周期反转时，资金链会不会断裂？定增 37 亿补血，是不是已经“缺血”严重？

答：尊敬的投资者，您好。公司资产负债率自 2023 年来上升较快，主要系公司主营业务正处于快速增长期，对营运资金及研发投入的需求较大，同时新增并购贷款用于股权收购。公司资产负债率上升的情况符合行业特征，与公司业务规模及发展规划匹配。公司向特定对象发行股票所募集资金主要用于面向 AI 领域的高端存储器研发及产业化项目、半导体存储主控芯片系列研发项目等，以进一步增强公司综合竞争力和可持续发展能力。感谢您的关注。

23、存货 180 亿、占资产近 50%，一旦存储价格下跌，巨额减值会不会直接把公司亏到退市？有没有做过压力测试？

答：尊敬的投资者，您好。公司库存水位处于健康合理区间，与公司业务规模及发展规划匹配，也使公司得以更好地平衡采购策略的风险及收益。感谢您的关注。

24、一季报显示公司存货大幅度增加，经营性现金流大幅下降，可否认为公司认为目前存储高景气周期可以有延续

到 27 年？目前供不应求的局面，是需求端大幅增长还是因为供给端国外大厂转产导致的？公司未来的规划是侧重于消费电子类也就是端侧还是 AI 训练和推理相关的产品？

答：尊敬的投资者，您好。AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量。云端 AI 相关的 HBM、RDIMM、eSSD 等产品已经消耗了大量现有产能，后续端侧 AI 存储需求也将进一步释放。晶圆原厂产能目前难以满足存储需求，且产能扩张需要一定扩产周期，因此存储产业未来一段时间仍将呈现供不应求的产业格局。

面对半导体存储市场持续的价格上涨与供应紧缺，公司将依托于多年积累的全栈式技术能力，以技术、制造、品牌为核心，向 AI 存储、高端存储、自主品牌、海外市场方向深化布局，持续强化公司在芯片与存储器核心技术领域上的领先优势，把握端侧 AI 落地的历史性机遇，不断提升高技术价值、高成长性与高战略协同性客户的占比，巩固并扩大公司在全球半导体存储产业的领先地位。感谢您的关注。

25、一边喊“AI 存储黄金十年”，一边密集减持，如何向中小投资者解释这种言行不一？是否存在利用信息差高位出货？

答：尊敬的投资者，您好。公司近期的董事以及高级管理人员减持，主要系公司股东个人资金需求安排，与公司生产经营情况无关。从行业来看，受 AI 需求拉动以及存储晶圆原厂资本开支谨慎及投入存在结构性差异的影响，目前存储行业处于高景气周期，您可以通过查阅公司公布的相关投资者关系活动记录表或者第三方信息了解更多。最后，公司作为行业领先企业，目前生产经营正常，正在积极把握行业的历史性机遇，依托自研存储芯片、自研主控芯片、自有封测平台等核心技术优势，继续保持行业以及资本市场的领先

优势。感谢您的关注。

26、员工持股平台和高管在股价最高点附近集体减持，是否提前知晓行业周期拐点或业绩见顶信号？

答：尊敬的投资者，您好。公司近期的员工持股平台和高管减持，主要系公司股东自身资金需求安排，与公司生产经营情况无关。从行业来看，受 AI 需求拉动以及存储晶圆原厂资本开支谨慎及投入存在结构性差异的影响，目前存储行业处于高景气周期，您可以通过查阅公司公布的相关投资者关系活动记录表或者第三方信息了解更多。最后，公司作为行业领先企业，目前生产经营正常，正在积极把握行业的历史性机遇，依托自研存储芯片、自研主控芯片、自有封测平台等核心技术优势，继续保持行业以及资本市场的领先优势。感谢您的关注。

27、请问贵公司 Q2 业绩如何，跟一季度比是否有增长？

答：尊敬的投资者，您好。目前公司整体经营态势持续向好，具体二季度业绩情况请关注公司定期报告。感谢您的关注。

28、由于技术不断地革新，市场同行不断扩大产能，现有的库存会不会产生技术落后的现象？

答：尊敬的投资者，您好。公司将密切关注市场需求变化，及时根据市场与生产情况调整生产计划，在保障客户需求的同时控制生产备货风险。感谢您的关注。

29、请问贵公司，今年的存货越来越高，能否解答理由？还有公司在港股上市的时间有没有具体确定？

答：尊敬的投资者，您好。公司库存水位处于健康合理区间，与公司业务规模及发展规划匹配，也使公司得以更好地平衡采购策略的风险及收益。关于港股发行上市事项，公司将根据其进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

30、公司这么高的库存，为什么不抓紧市场高位及时降低库存？

答：尊敬的投资者，您好。公司库存水位处于健康合理区间，与公司业务规模及发展规划匹配，也使公司得以更好地平衡采购策略的风险及收益。感谢您的关注。

31、蔡总，您好，未来一年有减持股份的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司实控人及部分董事此前已自愿承诺十二个月内不主动减持公司股份，彰显了其对公司未来持续发展和长期投资价值的信心。后续若涉及其他应披露事项，公司将及时予以公告。感谢您的关注。

32、根据3月份和4月份内存市场价格的下降，请问未来1-2年存储市场的价格能够持续高位吗，特别是江波龙高库存的情况下，这种价格的波动是不是对公司存货高影响特别大？

答：尊敬的投资者，您好。公司库存水位处于健康合理区间，与公司业务规模及发展规划匹配，也使公司得以更好地平衡采购策略的风险及收益。感谢您的关注。

33、江波龙的业绩很亮眼，但相对于业绩，股票市场的表现不如业绩这么亮眼，那后面江波龙的市值管理有什么动作或规划？

答：尊敬的投资者，您好。公司已制定市值管理制度，措施包括：聚焦主业提升业绩、稳定现金分红、适时推进回购与股权激励、加强投资者沟通、规范信息披露，以长期价值增长维护股东利益。感谢您的关注。

34、今年利润能200亿吗？

答：尊敬的投资者，您好。目前公司整体经营态势持续向好，具体业绩情况请关注公司定期报告。感谢您的关注。

35、您好，对贵公司在2026年度经营的展望可以谈一谈吗？

答：尊敬的投资者，您好。面对半导体存储市场持续的价格上涨与供应紧缺，公司将依托于多年积累的全栈式技术能力，以技术、制造、品牌为核心，向 AI 存储、高端存储、自主品牌、海外市场方向深化布局，持续强化公司在芯片与存储器核心技术领域上的领先优势，把握端侧 AI 落地的历史性机遇，不断提升高技术价值、高成长性与高战略协同性客户的占比，巩固并扩大公司在全球半导体存储产业的领先地位。感谢您的关注。

36、公司创新的 TCM（技术合约制造）模式，有效平滑了行业周期波动，请问目前 TCM 模式的业务规模占比达到多少？未来针对 TCM 模式有哪些拓展计划？如何通过该模式进一步强化与上游原厂、下游客户的深度绑定，提升公司的产业链话语权？

答：尊敬的投资者，您好。TCM 模式可以实现原厂、江波龙和客户三方的信息互通，目前公司 TCM 模式的技术和运营准备已经完成，部分案例已经落地，但在整体营收中的占比仍然较低。TCM 模式是公司长期的战略方向，模式落地后会对公司利润贡献有明显提升，公司将在遵循企业会计准则的前提下，持续扩大 TCM 模式业务在营收中的占比。感谢您的关注。

37、公司在年报中提出，将审慎通过增发、境外 IPO 等方式筹措资金，并有选择性地开展并购。请问公司未来的融资计划是怎样的？针对并购，重点关注哪些领域与标的？如何保障融资与并购行为不会稀释中小股东的利益，反而能提升公司长期价值？

答：尊敬的投资者，您好。A 股的再融资，或者境外上市，均系公司通过获取募集资金的方式有效率的投向核心主业，做大做强的手段，在这一点上，两者之间并没有必然的冲突或者替代关系。近年来，A 股市场不断完善，公司在 A

股市场的助力下取得了更长足发展。公司一直在统筹考虑包括再融资、境外上市等在内的支持公司长期发展的配套举措。若有相关重大进展，公司将严格按照相关法律法规及时进行信息披露。感谢您的关注。

38、现在 DDR5 内存条价格有大幅度下降吗？

答：尊敬的投资者，您好。AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量。云端 AI 相关的 HBM、RDIMM、eSSD 等产品已经消耗了大量现有产能，后续端侧 AI 存储需求也将进一步释放。晶圆原厂产能目前难以满足存储需求，且产能扩张需要一定扩产周期，因此存储产业未来一段时间仍将呈现供不应求的产业格局。感谢您的关注。

39、请问公司一季业绩很好，市场关心持续性。公司业绩与市值严重不匹配啊？

答：尊敬的投资者，您好。面对半导体存储市场持续的价格上涨与供应紧缺，公司将依托于多年积累的全栈式技术能力，以技术、制造、品牌为核心，向 AI 存储、高端存储、自主品牌、海外市场方向深化布局，持续强化公司在芯片与存储器核心技术领域上的领先优势，把握端侧 AI 落地的历史性机遇，不断提升高技术价值、高成长性与高战略协同性客户的占比，巩固并扩大公司在全球半导体存储产业的领先地位。上市企业股价表现，除受基本面因素影响外，还受到宏观经济环境、市场风险偏好、流动性等多重外部因素的综合影响，请基于自身风险承受能力，综合考虑各类因素理性决策，并充分注意投资风险。感谢您的关注。

40、针对全球存储晶圆寡头垄断的格局，公司在国产替代方面有哪些具体布局？与长江存储、长鑫存储等国内晶圆厂的合作规模、合作深度如何？未来 3 年，公司计划将国产颗粒的采购占比提升至多少？有哪些具体的落地措施？

答：尊敬的投资者，您好。公司已与包括长江存储、长鑫存储在内的全球主要晶圆原厂达成深层次、多角度的合作关系，在晶圆供应保障上具备明显优势。感谢您的关注。

41、公司 2026 年一季度综合毛利率大幅提升至 55.53%，远超行业平均水平，请问毛利率大幅跃升的核心驱动因素中，存储涨价周期、产品结构升级、自研技术降本分别贡献了多少比例？未来维持高毛利率的可持续性如何？若存储价格进入下行周期，公司有哪些措施维持盈利能力的稳定？

答：尊敬的投资者，您好。公司产品毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响。未来，公司将通过持续产品创新及技术服务等维护现有客户并持续拓展新客户、新市场，优化客户结构将带来业务规模和收入的增长，以提高公司未来盈利能力和财务状况。感谢您的关注。

42、请展望一下未来几年存储行业的发展前景，其价格走势？

答：尊敬的投资者，您好。AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量。云端 AI 相关的 HBM、RDIMM、eSSD 等产品已经消耗了大量现有产能，后续端侧 AI 存储需求也将进一步释放。晶圆原厂产能目前难以满足存储需求，且产能扩张需要一定扩产周期，因此存储产业未来一段时间仍将呈现供不应求的产业格局。感谢您的关注。

43、2026 年一季度末公司资产负债率升至 65.55%，长期借款较年初增长 115.46%，在行业高景气周期公司大幅加杠杆的核心考量是什么？公司的最优资产负债率目标区间是多少？针对利率波动、汇率波动带来的财务风险，公司有哪些具体的对冲与管控措施？

答：尊敬的投资者，您好。公司资产负债率自 2023 年来上升较快，主要系公司主营业务正处于快速增长期，对营运资金及研发投入的需求较大，同时新增并购贷款用于股权收购。公司资产负债率上升的情况符合行业特征，与公司业务规模及发展规划匹配。针对利率与汇率风险，公司通过优化融资结构、外汇套期保值、全球化运营分散等方式进行严格管控。感谢您的关注。

44、公司 SOCAMM 2 产品已成功点亮，但尚未产生实质性收入贡献。请问这款产品预计何时能实现量产并贡献收入？在英伟达 Rubin 平台供应链中的进展如何？

答：尊敬的投资者，您好。SOCAMM2 是专为云端 AI 而设计的高性能内存产品，根据公司内部测试数据，SOCAMM2 功耗仅为标准 DDR5 RDIMM 的 1/3，在同容量下带宽提升至 2.5 倍，结合 CPU 布局，能够全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点。目前，公司 SOCAMM2 产品已成功点亮，公司将积极探索相关的应用场景，保持在同行业中技术及产品的领先优势，但该产品目前尚未产生实质性收入贡献，请留意投资风险。感谢您的关注。

45、蔡总，这么好的业绩和净利润，是否考虑回购部分股份，做公司核心人员的股权激励。公司目前在 HBM 方面是否有推进和研发？

答：尊敬的投资者，您好。上市公司回购事项需综合多方因素而定，后续公司如有回购相关计划，将严格按照相关法律法规及时进行信息披露。目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂为主导，公司并未从事 HBM 的专项研发。感谢您的关注。

46、关于上游供应链安全：2025 年报提及原材料供应商集中度较高且境外采购占比大。面对复杂的国际贸易政策

环境，公司与原厂续签的 LTA（长期协议）能否保证晶圆供应的绝对安全？在国内晶圆替代(长江、长鑫等)方面是否有明确的比例目标？未来 5 年国产代替比例大概会有多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，通过签署长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），为公司未来发展构建起了有韧性及有保障的晶圆供应体系。感谢您的关注。

47、请问存储景气周期里，江波龙坚持定增，如何做到合理的市值管理？

答：尊敬的投资者，您好。公司已制定市值管理制度，措施包括：聚焦主业提升业绩、稳定现金分红、适时推进回购与股权激励、加强投资者沟通、规范信息披露，以长期价值增长维护股东利益。实现合理市值管理，维护全体股东利益。感谢您的关注。

48、请介绍一下贵公司的主营业务与德明利和佰维存储的有哪些异同？

答：尊敬的投资者，您好。公司作为全球领先的半导体存储品牌企业，具备涵盖芯片（主控芯片及存储芯片）设计、固件算法开发、封测制造等关键环节的全栈式技术能力，使得公司在产品创新、市场响应和定制化服务等方面形成差异化的竞争优势。辅以公司长期以来的前瞻性布局，在品牌建设、全球化运营以及与上下游深度协作等方面形成的软实力优势，进一步巩固了公司的市场领先地位，并形成了强大的市场竞争壁垒。面向端侧 AI 落地趋势，公司已经推出了包括 SPU、UFS 4.1、mSSD、ePOP5x 等面向各类端侧应用场景的高端产品，公司将依托领先、全面的芯片与存储产品布局，精准卡位前沿赛道，巩固并扩大领先优势，实现盈利能力的持续跃升。感谢您的关注。

49、关于车规级存储布局：公司车规级 UFS 和 eMMC 已进入北美自动驾驶巨头和多家知名车企供应链。针对愈发激烈的汽车价格战，车企对 BOM 成本极度敏感，这是否会压缩我们车规级存储产品的毛利率空间？车规产品的毛利空间目标是多少？

答：尊敬的投资者，您好。车规级存储认证壁垒高、客户粘性强、定价较稳健。公司将通过高端化、定制化等技术优势持续提高车规产品的盈利能力。具体业务的业绩情况，请您以公司发布的定期报告为准。感谢您的关注。

50、关于企业级存储的市占率：“2025 年公司企业级存储业务收入 17.83 亿元，增速近翻倍。在 AI 服务器需求爆发的当下，我们的 eSSD 和 RDIMM 产品在互联网大厂集采中的份额目标是多少？SOCAMM 产品的量产节点规划在何时？”

答：尊敬的投资者，您好。在企业级存储领域，公司已推出最大容量为 256GB 的 DDR5 RDIMM 产品，企业级 DDR5 内存条涵盖从 16GB 至 256GB 主流全容量系列，完成了 AMD Threadripper PRO 9000WX 系列兼容性认证，加深了与 AMD 和 Intel AVL 官方认证合作，并在国产鲲鹏、海光、飞腾等多个国产 CPU 平台实现服务器兼容性验证，适用于电信、金融、互联网等各类场景。针对目前 AI 加速落地情况，公司积极抓住存储行业新的发展趋势，已点亮 SOCAMM 产品，结合 MRDIMM、LPCAMM2、CAMM2、CXL2.0 内存拓展模块补齐未来产品版图，提供持续的服务客户能力。感谢您的关注。

51、如何抓住当前难得机遇，使公司发展具有可持续性，成为一个世界性伟大公司？

答：尊敬的投资者，您好。面对半导体存储市场持续的价格上涨与供应紧缺，公司将依托于多年积累的全栈式技术

能力，以技术、制造、品牌为核心，向 AI 存储、高端存储、自主品牌、海外市场方向深化布局，持续强化公司在芯片与存储器核心技术领域上的领先优势，把握端侧 AI 落地的历史性机遇，不断提升高技术价值、高成长性与高战略协同性客户的占比，巩固并扩大公司在全球半导体存储产业的领先地位。

研发方面，持续投资关键技术，聚焦自研芯片、AI 存储、车规级存储等高壁垒领域，进一步夯实公司的技术以及产品能力。制造方面，完善自身全球制造业务链布局，整合封装测试技术，提高产品品质和交付效率，增强产品创新能力与综合竞争力。品牌方面，将坚持以品牌为载体，通过丰富自主品牌内涵，加大品牌市场宣传以及提高用户粘性，让品牌为业务赋能，提升品牌附加值。感谢您的关注。

52、尊敬的董秘，您好，一季报近 180 亿存货，成本核算是不是采取的移动平均加权法？22 亿合同负债增长 22 倍，其中 AI 存储订单高吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司存货成本核算严格按照企业会计准则执行，具体会计政策请以公司定期报告披露内容为准。有关订单情况请以公司披露的公告为准。感谢您的关注。

53、尊敬的董秘，您好，公司在 AI 存储方面有哪些产品开始或者即将贡献收入？公司在产品规划方面是否倾向更高毛利的 AI 存储产品？

答：尊敬的投资者，您好。公司将不断丰富面向未来的技术型产品组合，全面提升产品质量与市场竞争力。依托原厂与客户的深度协同，重点布局端侧 AI 设备、AI 服务器、具身智能等高壁垒、高粘性的下游应用场景。通过自研芯片、自研固件、自主封测的全栈式技术能力，打造差异化技术护城河，积极把握 AI 驱动下存储需求爆发的战略机遇。感谢

您的关注。

54、请问公司在后续有没有分红计划？

答：尊敬的投资者，您好。公司董事会将根据相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，综合考虑公司经营业绩、现金流状况、发展战略及资金安排等因素，审慎研究利润分配事项。是否实施利润分配及具体方案，将由董事会审议通过后提交股东会审议决定。公司将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

55、后续模組的销售毛利可以维持吗？

答：尊敬的投资者，您好。未来，公司将通过持续产品创新及技术服务等维护现有客户并持续拓展新客户、新市场，优化客户结构将带来业务规模和收入的增长，以提高公司未来盈利能力和财务状况。感谢您的关注。

56、华泰证券郭龙飞分析师今天出了份研报，研报说贵司的利润将逐季下滑。甚至在明年利润直接减半。很明确的看空贵司。这种情况会发生吗？贵司是如何看待这几年的存储周期呢？可否预判一下，谢谢

答：尊敬的投资者，您好。华泰证券的研报给公司的是“买入”评级，并非看空公司。券商研报仅代表第三方观点。AI在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量。云端AI相关的HBM、RDIMM、eSSD等产品已经消耗了大量现有产能，后续端侧AI存储需求也将进一步释放。晶圆原厂产能目前难以满足存储需求，且产能扩张需要一定扩产周期，因此存储产业未来一段时间仍将呈现供不应求的产业格局。感谢您的关注。

57、用一到二句话说公司未来的核心竞争力是什么，与其他公司的差异？

答：尊敬的投资者，您好。公司在多个产业关键技术环

节领先的基础上，将芯片（主控芯片及存储芯片）设计、固件算法开发、封装测试以及生产制造等核心能力有机整合，形成了一套完整且高效的产业能力链条，使得公司在产品创新、市场响应和定制化服务等方面形成差异化的竞争优势。辅以公司前瞻性布局，在品牌建设、全球化运营以及与上下游深度协作等方面形成的软实力优势，进一步巩固了公司的市场领先地位，并形成了强大市场竞争壁垒。系统性的优势组合，使公司能够打破传统存储器企业的藩篱，在业务布局和商业模式创新上展现出强大的生命力，推动公司不断超越现有业务边界，塑造未来产业发展的新格局。感谢您的关注。

58、利润涨了那么多，能不能回购股票注销啊？

答：尊敬的投资者，您好。上市公司回购事项需综合多方因素而定，后续公司如有回购相关计划，将严格按照相关法律法规及时进行信息披露。感谢您的关注。

59、请问董事长，如何看待业绩大涨却股价不涨这个现象，公司准备如何进行市值管理，维护股东权益？

答：尊敬的投资者，您好。上市企业股价表现，除受基本面因素影响外，还受到宏观经济环境、市场风险偏好、流动性等多重外部因素的综合影响，请基于自身风险承受能力，综合考虑各类因素理性决策，并充分注意投资风险。公司已制定市值管理制度，措施包括：聚焦主业提升业绩、稳定现金分红、适时推进回购与股权激励、加强投资者沟通、规范信息披露，以长期价值增长维护股东利益。感谢您的关注。

60、请问江波龙在全球同行业当中处于什么地位？

答：尊敬的投资者，您好。根据灼识咨询的数据，公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业。公司是少数在存储器 B2B 和 B2C 市场均拥有独立品牌的中国公司，旗下各品牌长期稳居全球及区域多个细分品类

的前列，2025 年公司荣获国家级制造业单项冠军企业的荣誉，进一步彰显了公司在存储领域的卓越地位。感谢您的关注。

61、贵公司有什么长远目标，是否有一天能追赶上三星等大厂的技术？

答：尊敬的投资者，您好。公司将依托于多年积累的全栈式技术能力，以技术、制造、品牌为核心，向 AI 存储、高端存储、自主品牌、海外市场方向深化布局，持续强化公司在芯片与存储器核心技术领域上的领先优势，把握端侧 AI 落地的历史性机遇，不断提升高技术价值、高成长性与高战略协同性客户的占比，巩固并扩大公司在全球半导体存储产业的领先地位。感谢您的关注。

62、请问，董事长先生，公司企业级存储占比多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司持续深化在 AI 服务器、数据中心领域的存储业务布局，企业级存储产品已成功导入部分头部互联网企业、服务器厂商的供应链体系中。2025 年公司企业级存储业务收入达到 17.83 亿元，同比增长 93.30%。感谢您的关注。

63、内存价格上涨，上游的经营厂商如三星、海力士凭借晶圆垄断优势充分享受了上涨带来的收益，贵公司是否上游延伸投资的规划？

答：尊敬的投资者，您好。公司将根据业务发展节奏与资本市场环境，在国内外有选择性地评估并购机会，聚焦芯片设计、固件开发、封装测试等关键环节，优先遴选在技术、产品或区域布局上与公司现有优势形成互补的优质标的。通过战略性投资，强化垂直整合能力、丰富高端产品组合，并拓展全球市场覆盖，持续提升综合竞争力。感谢您的关注。

64、蔡总，请问今年一季度咱公司旗下存储有用于 AI 算力方面吗

答：尊敬的投资者，您好。公司推出了 SATA SSD、PCIe SSD、RDIMM 等企业级存储产品，并前沿布局了以 SOCAMM、MRDIMM 为代表的多款新一代高性能存储产品。公司企业级存储产品已导入头部互联网企业的供应链体系中，客户涵盖运营商、互联网企业、服务器厂商等。在目前存储晶圆供应偏紧背景下，公司将维持聚焦高附加值、高技术壁垒项目的经营策略，持续深化与多个领域知名客户的研发项目合作。具体产品进展请以公司公开发布的信息为准。感谢您的关注。

65、我们看到公司已与闪迪等行业巨头达成战略合作，推动 UFS 产品及 TCM 模式。请问在 2026 年第二季度，公司除了消费电子外，在汽车存储或工业级存储的高端 Tier1 客户导入方面是否有新的突破？这种高端化转型对于提升公司整体的净资产收益率（ROE）将起到多大作用？

答：尊敬的投资者，您好。公司作为业内较早进入车规级存储领域的企业，构建了涵盖 UFS、eMMC、LPDDR、USB 在内的车规级存储产品矩阵。基于车规产品验证周期长、准入门槛高的特点，公司先后通过汽车行业核心标准体系的 AEC-Q100 认证和德国 TÜV 莱茵 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，公司已经开始直接向北美智能汽车及自动驾驶科技巨头供应车规级存储产品，而且也进入了全球众多知名车企的供应链体系。公司已推出了工规级 DDR5 DIMM、工规级 4TB 大容量 SATA SSD、工规级 PCIe Gen4 SSD 等，全面支持宽温环境，充分满足工业自动化、轨道交通、智能制造、DPU 智能网卡、电网设备领域对存储性能和可靠性的高要求。感谢您的关注。

66、公司近期发布的集成封装 mSSD 以及针对 AI 场景的 SOCAMM 内存条非常受市场关注。请问这些面向 AIPC 和高端计算的新产品，目前是否已获得客户批量订单或具体

的导入时间表？另外，在企业级存储（eSSD 和 RDIMM）方面，今年的营收占比目标是否有指引？

答：尊敬的投资者，您好。公司 mSSD 产品目前已获得众多头部 PC 厂商的深度认可，将在 2026 年实现规模化商业应用，公司正着力推动 mSSD 成为端侧 AI 领域的新型产品标准，并计划以此为引擎，在端侧 AI 爆发的浪潮中实现业绩的持续增长。目前，公司 SOCAMM2 产品已成功点亮，公司将积极探索相关的应用场景，保持在同行业中技术及产品的领先优势。2025 年公司企业级存储业务收入达到 17.83 亿元，同比增长 93.30%，其 2026 年营收情况请以定期报告披露为准。感谢您的关注。

67、董事长好。我关注到行业自去年进入涨价周期，叠加 AI 需求拉动，同业普遍在消化低价库存红利。请问公司目前库存结构如何？考虑到二季度是传统备货旺季，当前在手订单能见度有多高？另外，随着原厂产能调整及涨价趋势延续，公司如何判断存储涨价对整个二季度利润弹性的影响？

答：尊敬的投资者，您好。公司库存水位处于健康合理区间，与公司业务规模及发展规划匹配，也使公司得以更好地平衡采购策略的风险及收益。有关业绩及订单相关数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

68、一季度有 40 亿利润么？

答：尊敬的投资者，您好。公司 2026 年一季度归母净利润为 38.62 亿元，扣除非经常性损益后净利润 39.43 亿元，整体业绩符合存储行业发展趋势，具体以公司已披露的一季报数据为准。感谢您的关注。

69、请问贵公司定增目前是什么进度？

答：尊敬的投资者，您好。公司向特定对象发行 A 股股票事项正在持续推进中，后续进展请您持续关注公司公

	<p>告。感谢您的关注。</p> <p>70、领导，您好！我来自四川大决策 请问，搭载自研主控的 UFS4.1 产品已进入哪些头部智能终端厂商的供应链？批量出货的时间节点和规模预期如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。基于自研 UFS4.1 主控芯片，公司 UFS4.1 产品的多项性能超越市场同类产品，并支持在 UFS 中同时使用混合存储介质（hybrid），能够有效的平衡 TLC 和 QLC 介质各自的特点。公司正全力推进 UFS 产品的更广泛应用。目前，公司已与包括闪迪在内的多家晶圆原厂，以及多家头部智能手机厂商达成了 UFS4.1 的合作。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>